

本期封面



2000年10期

栏目:

DOI:

论文题目: 倒装焊底充胶分层与SnPb焊点热疲劳的可靠性

作者姓名: 张群 谢晓明

工作单位: 上海新代车辆技术有限公司, 上海 200050

通信作者: 张群

通信作者Email: xmxie@itsvr.sim.an.cn

文章摘要: 采用实验和有限元模拟, 研究了底充胶分层和SnPb焊点的可靠性. 结果表明, 底充胶分层易发生在芯片/底充胶界面边缘处; 当底充胶与芯片粘合强度较弱时, 底充胶的早期分层是焊点中裂纹萌生扩展从而导致失效的直接原因; 当底充胶与芯片粘合强度较强时, 分层可以削弱底充胶对焊点的机械耦合作用, 从而影响焊点的热循环寿命, 此时, 焊点热疲劳裂纹是焊点失效的直接原因.

关键词: 倒装焊 底充胶 SnPb焊点

分类号: TG405.94

关闭